

2019年4月24日

会社名 : 株式会社ディスコ
代表者名 : 代表取締役社長 関家一馬
コード番号 : 6146 東証第一部
問い合わせ先 : 広報室 (03-4590-1090)

長野事業所・茅野工場 新棟の建設を決定

半導体製造装置メーカー・株式会社ディスコ（本社：東京都大田区、社長：関家一馬）は、約175億円を投資し、長野事業所・茅野工場（長野県茅野市）に免震構造の新棟を建設することを決定しました。



茅野工場新棟 建設の目的

第5世代通信システム（5G）導入の動きが加速していることなどを背景に、IoT、自動運転、遠隔医療技術の進展など半導体・電子部品市場の拡大が予想されています。これに伴い、当社の精密加工装置^{※1}・精密加工ツール^{※2}の需要も拡大することが見込まれます。このような市場環境に対し、桑畑工場（広島県呉市）の増築^{※3}にて対応を進めておりますが、更なる生産体制の強化が必要と判断しました。

また、精密加工装置および精密加工ツールの大半を、現在は広島県の呉工場と桑畑工場にて生産しております。両工場とも免震構造を採用し、断水を想定した独自水源の確保に向け工事を進めるなど対策をとっておりますが、2つの工場間の距離は10km程度であるため、災害が広域に及ぶ場合を想定し、更なるリスク分散を図る必要がありました。

これらを背景に、茅野工場新棟の建設を決定いたしました。

※1 精密加工装置：シリコンウェーハ等の切断・研削・研磨を行う機械

※2 精密加工ツール：精密加工装置に装着して切断・研削などの加工をおこなうツールで、頻繁に交換される消耗品

※3 [桑畑工場A棟Cゾーン竣工、Dゾーン着工に関するニュースリリース（2019年1月31日）](#)

茅野工場新棟 概要

名称	株式会社ディスコ長野事業所・茅野工場 B 棟 (仮称)
建屋規模・構造	10F 建・免震構造
延べ床面積	131,920.00 m ² (既存棟は約 20,293.43 m ²)
建築面積	16,280.00 m ² (既存棟は 4,018.11 m ²)
敷地面積	71,044.40 m ²
投資総額	約 175 億円

今後の計画

着工： 2019 年 7 月 (予定)

竣工： 2020 年 12 月 (予定)

以上